

京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」 先端光加工プロジェクト

先端光加工セクション

京都レーザーテックオープンデイ 開催案内

【日 時】 平成31年1月28日（月）（13時00分より受付）

13時30分～16時00分

【場 所】 京都大学大学院工学研究科イノベーションプラザ棟2階 会議室
（京都市西京区御陵大原1-30 京大桂イノベーションパーク内）

【対 象】 ナノ～サブミクロンレベルの微細加工技術に関心をお持ちの事業者

【参加費】 無料

【主 催】 京都市, 次世代レーザープロセッシング技術研究組合,
（公財）京都高度技術研究所

【定 員】 20名（先着順）

【スケジュール】

13:00～	開場・受付
13:30～13:35	主催者挨拶
13:35～13:45	プロジェクトの概要説明
13:45～14:15	「FIB/SEMの基礎と応用」 （日本電子株式会社 副主査 柴田昌照）
14:15～14:45	「私がFIBを使用した理由：シリコン表面での 局所選択的な金ナノ構造成長とその体積評価」 （京都大学大学院 工学研究科 講師 西正之）
＜休憩 15分間＞	
15:00～16:00	FIBの操作体験および他の設備の見学
16:00	閉会

【申込方法】 「オープンデイ参加希望」と題したメールに以下の内容を添えてください。

1. お名前 2. 所属・役職 3. 連絡先（電話番号、E-mailアドレス）

（申込み先 E-mailアドレス：info@laserprocessing.jp）

【問い合わせ先】 次世代レーザープロセッシング技術研究組合 事務局（担当: 広本）

URL: <http://www.laserprocessing.jp/>

TEL: 075-381-7990